



道尔威 国际前沿电子材料首选品牌



微信扫一扫
关注道尔威

低温固化粘合剂

低温固化粘合剂主要应用于：晶圆级芯片规模封装(WLCSP)、近芯片尺寸球栅陈列(BGA)、芯片规模封装(CSP)、影像模组和图像传感器、指纹传感器、LED背光透镜组装、触摸面板、电路板保护、VCM马达，可穿戴式设备组装等行业。

1. 单组分粘合剂，室温条件下的工作寿命较长；
2. 对各种基材（包括玻璃、金属各常用低温稳定性塑料如PC、LCP、PA、PBT、ABS、PPA和各种不同阻焊膜的FR4）具有高附着力；
3. 高可靠性(防脱落、耐冲击、耐高温高湿和温度循环)；
4. 低应力，高延展性；
5. 易于应用的液体，膏体或者薄膜方案，快速流动，工艺简单；
6. 流动性可控的解决方案，毛细流动性；
7. 平衡的可靠性和返修性；
8. 高可靠性边角补强粘合剂（替换底部填充剂）；



☎ 电话: +86 0512 62518381
✉ 邮箱: peace.jiang@hk Smy.com
🌐 网址: WWW.dewsz.com.cn

道尔威(苏州)粘合剂有限公司



道尔威 国际前沿电子材料首选品牌



微信扫一扫
关注道尔威

产品名称	特 性	颜 色	25℃粘度 (mPa.s)	硬化条件	Tg(°C)	热膨胀系数 α1:ppm	在 25℃的适合 用期 (小时)
DE9623	超快速固化 高韧性,低收缩性	白色	12000	80°C/3min 70°C/10min	39	71-220	14 days
DE9627M	为影像模组组装设计 固化速度快、高韧性	黑色	20000	80°C/10min	38	71-220	3 days
DE9621E	VCM马达组装 低树脂渗出	黑色	12000	80°C/10min	45		3 days
DE 9621L	优异的韧性，低粘度， 自流平，对PA和LCP 具有良好的粘结强度	黑色	5500	80°C/10min	39	65	3 days
DE9006	专为高可靠性便携式 设备设计，快速室温 流动性	黑色	480	130°C/8min	99	65	3 days

产品名称	特 性	颜 色	25℃粘度 (mPa.s)	硬化条件	Tg(°C)	热膨胀系数 α1:ppm	在 25℃的适合 用期 (小时)
DE9017	快速室温流动，CSP底部 填充，为FPC应用而设计 良好返修性	黑色	600	120°C/5min	42	65	3 days
DE9020	高密度PCB组件上的SMD 保护，低模量和柔软材料 低温快速固化	黑色	13000	130°C/8min	6.1	78	3 days
DE9022	高Tg CSP/BGA底部填充 室温快速流动 可返修	黑色	600	150°C/8min	124	60	3 days
DE9023	高可靠性，快速室温流动 CSP底部填充	黑色	600	150°C/8min	135	55	3 days
DE9301	为倒装芯片应用而设计， 高Tg低CTE，高可靠性	黑色	19900	165°C/120min	122	35	8H

☎ 电话: +86 0512 62518381
✉ 邮箱: peace.jiang@hksmy.com
🌐 网址: WWW.dewsz.com.cn

道尔威(苏州)粘合剂有限公司